

证券代码：300136

证券简称：信维通信

深圳市信维通信股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-02

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	<u>2021年1月28日</u> 华泰柏瑞、华安基金、睿远基金、财通资管、禾其投资、同犇投资、望正资产、新华资产、鑫元基金、上银基金、嘉实基金、中加基金、太保资产、毕盛投资、润晖投资、歌斐资产、中银基金、西部利得基金、民生通惠、浦银安盛、三井住友、中信保诚基、中海基金等，以及个人投资者张洪希、何小辉等。 以上排名不分先后。
时间	2021年1月28日
地点	2021年1月28日 深圳市南山区特发信息港A栋南2楼 电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：杨明辉 证券事务代表：卢信
投资者关系活动主要内容介绍	信维的使命： 致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值。 信维的愿景： 全球领先的一站式泛射频解决方案提供商。 第一部分：介绍公司2020年年度经营情况 2020年，公司收入保持着稳步向上的增长，特别是无线充电、5G天线业务有比较快速的增长。2020年，公司归母净利润区间9.7-10.7亿元，其中股权激励摊销费用1.85亿元，如果把这些因

素回算回去，净利润端还是有不错的增长。

在 2020 年的收入端，全年收入规模也在稳步增长，生产经营保持柔性、平稳、向好的发展势头。具体来看，在无线充电方面，公司 2020 年的增长比年初规划更好，得到大客户的认可，预计 2021 年依然保持强势势头；在 5G 天线方面，公司的增长也很迅速，目前我们是安卓 5G 机型的主力供应商；此外公司对连接器业务进行优化调整，板对板和闪电头业务也在不断起量，对公司营收作出贡献。

在 2020 年的经营中，公司毛利率也遇到了些挑战，从而利润端受到一些影响。具体的原因我们在业绩预告也写的比较详细，包括疫情、人民币升值、股权激励摊销等多方面的因素。目前，公司也抓各个事业部及子公司的运营管理，并加大产品的材料和零部件的自制力度，逐步提升毛利率。

第二部分：公司始终坚持加大研发投入，致力于打造一家技术驱动型企业。

公司一直以来非常重视研发投入，致力于打造一家技术驱动型企业，2019 年整体研发投入占营收的比重为 8.9%，2020 年预计超过 9%。这几年，我们一直不断加大研发投入，不断往上游基础材料、元件方面做延伸。过去，我们也一直强调信维致力于打造一家技术驱动型企业，想要做中国式村田。刚开始，很多人可能觉得我们只是喊喊口号；现在，有些朋友已经看到信维的决心，公司一直在坚持研发的投入，这里也需要大家给信维一点耐心。

信维为什么一直始终打造坚持一家技术驱动型企业？经过了过去十年的快速发展，中国诞生了一批优秀的消费电子零部件企业。发展至今天，我们这些企业都在做新的战略选择，有些企业开始往下游延伸做 FATP，做 FATP 的话收入规模可以很快做大。而信维选择了一条向上游材料延伸的路，不断加大研发投入，通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，强化技术壁垒，提升产品线的竞争力。在消费电子行业，从零组件模

组，这么坚决地往上游材料延伸，信维是为数不多的企业。做技术，我们直面的竞争对手，更多的是海外企业。只要我们坚持不断的投入，一个一个地攻克技术难关，我们可以做到更好，当然这会是一个漫长的过程。例如，在 高分子聚合物材料领域，公司已形成“LCP 材料→LCP 天线→LCP 模组”一站式解决方案能力，搭建了 LCP 生产线，具备量产能力，公司加大 LCP 业务开拓，LCP 材料的各项品质持续提升；在磁性材料领域，公司纳米晶、3D 铁氧体性能优异，已大量应用于出货给国内外大客户的无线充电产品中，硬磁材料也得到了大客户的认可，未来，公司将继续加大对各种磁性材料的研发投入，进一步提升产品竞争力；在 UWB 领域，公司 UWB 天线与模组技术水平行业领先，目前正在多个领域和国内外多家一线厂商联合开发 UWB 应用。信维新拓展的这些新领域，都有非常大的市场空间，要想这个领域分食蛋糕，就要求我们必须把技术做到极致。

整体来看，公司各项业务有序开展，经营规模持续扩大；公司不断加大对基础材料、基础技术的研究，逐步拓宽技术护城河，提升了产品线的竞争力，为更长远的发展奠定基础。

信维有什么样的研发布局？公司的技术研究模式有多种，一种是内部开发，依托我们的中央研究院；一种是技术整合，例如收购绵阳北斗加强我们的磁性材料技术，收购艾利门特获取粉末冶金能力。还有一种是产学合作，我们与世界上在天线射频领域优秀的院校保持紧密的合作。

目前，公司已设立 6 处前沿研发中心，地点分布于中国深圳、中国常州、美国圣地亚哥、日本新横滨、韩国水原、瑞典斯德哥尔摩，不断加强公司在射频基础技术、基础材料的研究。特别是公司在日本新增的高分子和陶瓷材料研究院，将助力我们在 LCP 和元件领域实现拓展，此外今年计划在京都继续设立研究院，加强感性材料、高分子材料等的研究，进一步巩固公司在射频材料领域的优势。

目前，公司在基础材料、基础技术的投入取得了一定的成效。国内、外大客户对公司的材料认可度非常高，将部分产品的前期需

求发给公司，公司根据客户的需求进行材料的设计与选择。公司凭借在基础材料、基础技术的投入，能够更前瞻、更深度地参与大客户的新产品项目，将助力公司业务的拓展。

第三部分：问答环节

问题：公司 LCP 业务的进展情况？

公司在 LCP 这个领域也沉淀了多年，已具备了从材料到工艺到 LCP 模组的全面能力，能够为客户提供从材料到工艺到 LCP 模组的一站式解决方案。公司能够提供更多规格、更高精度、更容易调节性能、更高品质、更低成本的 LCP 产品。信维努力把这项业务做好，目前还处于起步阶段，LCP 的市场空间也非常广阔。

目前，公司已经与十几家客户在做项目配合，包括国外客户、国内客户，其中部分客户已经实现了批量出货。为了应对客户的需求，公司搭建一条中规模的 LCP 生产线，该产线是含括 LCP 前道工艺和后道工艺的，并已与部分客户做了相关项目的前期接洽，预计今年业务规模会逐步扩大。

问题：LDS 天线在物联网的应用情况？

LDS 天线过去在高端手机中应用比较多，近年来 LDS 技术日趋成熟，应用越来越广泛，一方面在物联网中大量应用，另一方面在手机中还普及到更多中低端机型，此外在手表和耳机等其他精密电子产品中也会应用，正因为下游需求拓展了领域，所以 LDS 天线的应用场景依然广阔。

公司的 LDS 天线处于全球领先水平，目前已全面出货给主流手机厂商，同时公司在平板、笔记本电脑领域也拓展了“天线+RF Cable+射频连接器”一整套解决方案，其供应份额和价值量均有提升，公司也配合客户的需求继续做了相应的扩产。

问题：公司费用的管控规划如何？

公司通过搭建大客户平台，为客户提供一站式泛射频解决方案，

主要在以下几个模块进行费用管控，①管理费用：随着公司全球化布局，公司由早期仅在深圳和北京设立工厂到现在在常州、越南等多地设立研发生产基地，管理费用增长比较快，因此这也是我们未来重点管控的部分；②财务费用：公司通过对内实施预算管控继续完善和优化公司的财务费用管控；③销售费用：公司一直坚持大客户平台，销售费用一直控制得不错；④研发投入：公司所处的射频通信行业，从2G逐步发展到3G、4G、5G，未来再到6G，具有不断高频化的发展趋势。高频化意味着对射频材料的要求越来越高，这就要求我们要更加注重射频材料的能力建设，公司以每年研发投入占营业收入比例超8%的目标，不断提高研发投入，在5G天线、LCP、滤波器、UWB天线等新业务领域，做好技术储备和专利布局，希望能够在产品上提升技术壁垒。

问题：公司无线充电业务进展如何？公司的优势体现在哪里？无线充电发射端业务进展情况如何？

公司很早就开始布局无线充电业务领域，能够提供从材料到工艺到产品垂直一体化的解决方案。我们的优势在于垂直一体化，在于无线充电材料，无论是纳米晶材料还是铁氧体材料，我们都建立了充分的优势。公司无线充电的客户也覆盖了全球前几大手机厂商、全球知名汽车厂商，正在积极拓展全球智能家居厂商的客户。我们在无线充电上面的突破，有以下几点：

第一，公司无线充电在客户端的供应份额持续提升。凭借着公司的努力，我们在客户手机接收端产品的供应份额较以往实现了进一步提升。

第二，公司无线充电从手机接收端拓展到发射端。发射端的市场空间很大，厂商陆续推出无线充电器，我们也将无线充电从接收端拓展到发射端，并已经实现了批量出货。目前，公司在向国内客户批量出货发射端产品的同时，也在积极配合国际大客户的产品开发，目前进展顺利，未来将会覆盖更多的客户。

	<p>第三，公司无线充电的应用领域从手机端拓展到无线耳机等其他产品。智能手机只是无线充电的一个应用领域，公司已经在无线耳机、手表等 IOT 产品应用领域上取得了突破，未来将向更广泛的领域拓展。</p> <p>在无线充电领域，公司建立的优势明显，凭借自身的材料、工艺等优势，公司有能力保持行业领先地位，无线充电业务处于快速增长通道。</p> <p>问题：公司毫米波天线的进展？</p> <p>公司已开发包括陶瓷、AIP 等多种毫米波解决方案，已经与国内外客户做了合作。目前毫米波通讯网络覆盖较少，该业务的大规模拓展还需要一定时间。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2021-01-28